

UDC 621.382
L 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 7092—93

半导体集成电路外形尺寸

Outline dimensions of semiconductor
integrated circuits

1993-01-21 发布

1993-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

半导体集成电路外形尺寸

Outline dimensions of semiconductor
integrated circuits

GB/T 7092—93

代替 GB 7092—86

1 主题内容与适用范围

本标准规定了半导体集成电路(以下简称器件)的外形尺寸。
本标准适用于器件的成品尺寸的检验。

2 引用标准

- IEC 191 半导体器件机械标准化
- GB 1182 形状和位置公差 代号及其注法
- GB 1183 形状和位置公差 术语及定义
- GB 1184 形状和位置公差 未注公差的规定
- GB 4457.4 机械制图 图线
- GB 4458.1 机械制图 图样画法
- GB 4458.4 机械制图 尺寸注法

3 外形分类及代号

3.1 外形的类别

- a. F型 陶瓷扁平封装 (FP);
- b. H型 陶瓷熔封扁平封装 (CFP);
- c. D型 陶瓷双列封装 (DIP);
- d. J型 陶瓷熔封双列封装 (CDIP);
- e. P型 塑料双列封装 (PDIP);
- f. T型 金属圆形封装;
- g. O型 塑料双列弯引线封装 (SOP);
- h. E型 塑料片式载体封装 (PLCC);
- i. C型 陶瓷无引线片式载体封装 (CCC);
- j. N型 塑料四面引线扁平封装 (PQFP);
- k. Q型 陶瓷四面引线扁平封装 (QFP);
- l. G型 陶瓷针栅阵列封装 (PGA)。

3.2 外形代号

外形代号的编号方法按本标准附录 A(补充件)的规定。

4 引出端的编号及识别

4.1 F、H、N 和 Q 型封装